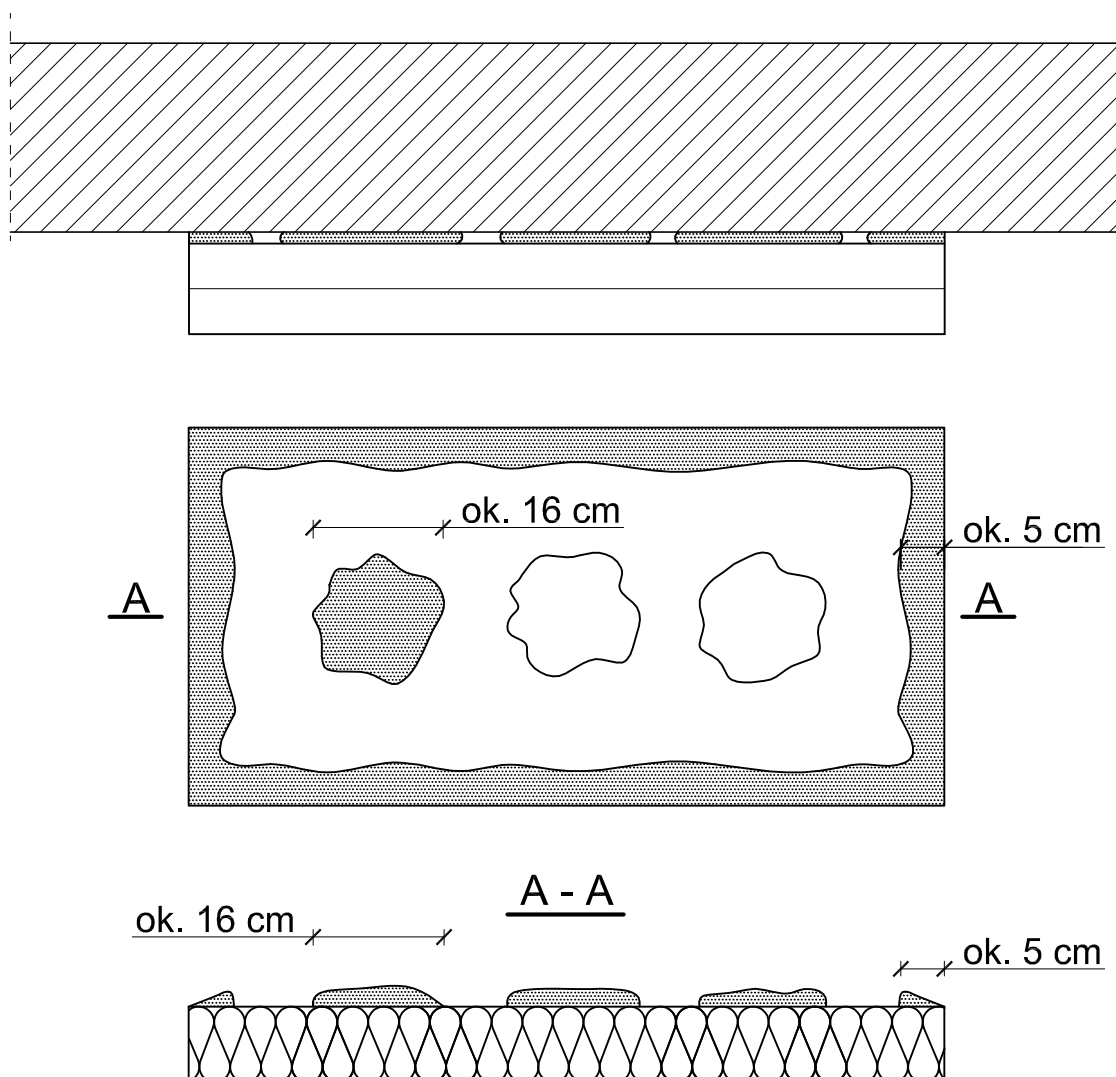


# Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



## Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwe i drewnopochodne, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

## Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku <b>S1</b>	Branża <b>ARCHITEKTURA</b>	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo	Adres budowy Gminne Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
				Tytuł rysunku <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: luty 2016r.	